****

|  |  |
| --- | --- |
| **Reader Enquiries:** | **Press Contact:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com[www.congatec.es](http://www.congatec.es)  | info@sams-network.com[www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |

**

*Texto y foto también disponible online en:* [*https://www.congatec.com/es/congatec/notas-de-prensa.html*](https://www.congatec.com/es/congatec/notas-de-prensa.html)

**Nota de prensa**

Nuevos módulos de congatec con procesadores Intel Core de 11ª generación para aplicaciones de automoción exterior e interior.

**Material caliente para temperaturas extremas**

**Deggendorf, Alemania, 10 de noviembre 2020 \* \* \*** congatec - proveedor líder de tecnología informática embebida y de vanguardia - presenta seis nuevos módulos COM (Computer-on-Modules) con procesadores Intel Core de 11ª generación para rango de temperatura ampliado. Construidos con componentes de alta calidad diseñados para soportar temperaturas extremas desde -40 a +85°C, los nuevos módulos COM (Computer-on-Modules) COM-HPC y COM Express Type 6 proporcionan todas las características y servicios necesarios para un funcionamiento fiable en los entornos más desafiantes.

El paquete de valores incluye opciones robustas de refrigeración pasiva, un revestimiento de conformidad opcional para la protección contra la corrosión por humedad o condensación, una lista de esquemas de placas carrier recomendadas y componentes adecuados para el rango de temperaturas ampliado para una mayor fiabilidad. Este impresionante conjunto de características técnicas se complementa con una completa oferta de servicios que incluye la monitorización de temperatura, pruebas de conformidad de la señal de alta velocidad junto con servicios de diseño propios y todas las sesiones de formación necesarias para simplificar el uso de las tecnologías informáticas embebidas de congatec.

Los casos típicos de uso de los nuevos módulos COM-HPC y COM Express de grado industrial pueden ser encontrados en cualquier tipo de aplicaciones robustas, dispositivos edge exterior e instalaciones a bordo de vehículos, que cada vez más aprovechan las funciones de visión embebida e inteligencia artificial (IA) para las que congatec proporciona también un amplio soporte. Los verticales típicos son la automatización industrial, el ferrocarril y el transporte, la infraestructura inteligente incluyendo aplicaciones de misión crítica como el sector de la energía, el petróleo y el gas, equipamiento para ambulancia móvil, telecomunicaciones, o la seguridad y la videovigilancia, por nombrar sólo algunos.

Basados en los nuevos SoC de baja potencia y alta densidad de Tiger Lake, los nuevos módulos para entornos amplios de temperatura ofrecen un rendimiento de CPU significativamente mayor y un rendimiento de GPU casi 3 veces superior [1], junto con el soporte de PCIe Gen4 y USB4 de última generación. Los gráficos y las cargas de trabajo de cálculo más exigentes se benefician de hasta 4 núcleos, 8 hilos y hasta 96 unidades de ejecución de gráficos para un rendimiento de procesamiento paralelo masivo de forma ultra-resistente. Los gráficos integrados pueden utilizarse como unidad de procesamiento paralelo para redes neuronales convolucionales (CNN) o como acelerador de IA y aprendizaje profundo (deep learning). Utilizando el kit de herramientas de software Intel OpenVINO que incluye llamadas optimizadas para OpenCV, núcleos de OpenCL™ y otras herramientas y bibliotecas de la industria, las cargas de trabajo pueden extenderse a través de unidades de cálculo de CPU, GPU y FPGA para acelerar las cargas de trabajo de la IA, incluyendo visión por ordenador, audio, voz, lenguaje y sistemas de recomendación.

El TDP es escalable de 12W a 28W, lo que permite diseños de sistemas UHD 4k realmente inmersivos con sólo refrigeración pasiva. Las impresionantes prestaciones del ultra-resistente módulo COM-HPC/cTLU de conga-HPC y del módulo COM Express Type 6 de conga-TC570 han sido puestas a disposición en un diseño capaz de funcionar en tiempo real y también incluye soporte de hipervisor en tiempo real de Real-Time Systems para despliegues de máquinas virtuales y consolidación de la carga de trabajo en escenarios de edge computing.

"Los servicios y el soporte son absolutamente claves para los productos basados en estándares. Por eso complementamos nuestra oferta de productos robustos para todas las nuevas aplicaciones edge en entornos difíciles con un completo ecosistema para cada producto... Esto incluye la optimización para el cálculo en tiempo real - incluyendo soporte para Time Sensitive Networking (TSN), Time Coordinated Computing (TCC) y RTS Realtime Systems Hypervisor, soporte de gestión remota y finalmente todos los servicios de conformidad de señal requeridos ya que la señalización de alta velocidad con PCIe Gen 4 y USB4 es un serio reto en estos días, haciendo que las tareas de diseño de las placas carrier sean cada vez más complejas", explica Andreas Bergbauer, Product Line Manager de congatec

**Conjunto de características al detalle**

El módulo conga-HPC/cTLU COM-HPC Client Size A, así como el módulo conga-TC570 COM Express Compact estarán disponibles con los nuevos procesadores escalables de Intel Core de 11ª generación para temperaturas extremas que van desde -40 a +85ºC. Ambos módulos son los primeros en soportar PCIe x4 en rendimiento Gen 4 para conectar periféricos con un ancho de banda masivo. Además, los diseñadores pueden aprovechar 8x PCIe Gen 3.0 x1 canales. Mientras que el módulo COM-HPC ofrece los últimos 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen 2 y 8x USB 2.0, el módulo COM Express ofrece 4x USB 3.2 Gen 2 y 8x USB 2.0 en conformidad con la especificación PICMG. Para la conexión en red, el módulo COM-HPC ofrece 2x 2.5 GbE, mientras que el módulo COM Express ejecuta 1x GbE, con ambos soportando TSN. El sonido se proporciona a través de I2S y SoundWire en la versión COM-HPC, y HDA en los módulos COM Express. Se proporcionan completos paquetes de soporte de la placa para todos los principales RTOS, incluyendo soporte de hipervisor de los sistemas de tiempo real, así como Linux, Windows y Android.

Los dos módulos COM-HPC basados en el procesador Intel Core de 11ª generación y COM Express Compact Type 6 están disponibles en las siguientes opciones de rango de temperatura ampliado:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Procesador** |  | **Núcleos/Threads** |  | **Frecuencia a 28/15/12W TDP, (Max Turbo) [GHz]** |  | **Cache [MB]** | **Unidades****Gráficas** **De Ejecución** |  |
|  | Intel® Core™ i7-1185GRE |  | 4/8 |  | 2.8/1.8/1.2 (4.4) |  | 12 | 96 |  |
|  | Intel® Core™ i5-1145GRE |  | 4/8 |  | 2.6/1.5/1.1 (4.1) |  | 8 | 80 |  |
|  | Intel® Core™ i3-1115GRE |  | 2/4 |  | 3.0/2.2/1.7 (3.9) |  | 6 | 48 |  |

Más información sobre el nuevo módulo COM-HPC/CTLU COM-HPC Client se puede encontrar en: <https://www.congatec.com/es/productos/com-hpc/conga-hpcctlu/>

El módulo COM Express Compact del conga-TC570 tiene su página principal aquí: <https://www.congatec.com/es/productos/com-express-type-6/conga-tc570/>

Más información sobre el lanzamiento del Intel Tiger Lake UP3 de congatec se puede encontrar en la página principal de aterrizaje: <https://congatec.com/11th-gen-intel-core/>

**Sobre congatec**

congatec es una empresa de tecnología de rápido crecimiento que se centra en productos informáticos embebidos y de vanguardia. Los módulos informáticos de alto rendimiento se utilizan en una amplia gama de aplicaciones y dispositivos en automatización industrial, tecnología médica, transporte, telecomunicaciones y muchas otros verticales. Respaldado por el accionista controlador DBAG Fund VIII, un fondo del mercado medio alemán que se enfoca en negocios industriales en crecimiento, congatec tiene la experiencia en financiación, fusiones y adquisiciones para aprovechar estas oportunidades de mercado en expansión. congatec es el líder del mercado global en el segmento de módulos COM con una excelente base de clientes desde nuevas empresas hasta compañías internacionales de primera línea. Fundada en 2004 y con sede en Deggendorf, Alemania, la empresa alcanzó una cifra de ventas de 126 millones USD en 2019. Más información disponible en nuestra web [www.congatec.com](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.congatec.com%2F&data=04%7C01%7C%7Cd6654884cfee4283460108d87b43e959%7C1b738660126645879d5454e9ad89e4cb%7C0%7C0%7C637394878932424857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=M6r1ukH%2B1yMwc0gunbmVRuBaaijO315wnAy2ocS4xvM%3D&reserved=0) o vía [LinkedIn](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F455449&data=04%7C01%7C%7Cd6654884cfee4283460108d87b43e959%7C1b738660126645879d5454e9ad89e4cb%7C0%7C0%7C637394878932434848%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FMg3YUv0q09oP%2BW7%2FXJLHYdiBdwZeZbi5jJ7p%2B99RSE%3D&reserved=0), [Twitter](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmobile.twitter.com%2FcongatecAG&data=04%7C01%7C%7Cd6654884cfee4283460108d87b43e959%7C1b738660126645879d5454e9ad89e4cb%7C0%7C0%7C637394878932444843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Fp9Z0BnXIz0%2FlzJYotRWqmFrCf6949cCxX%2BbVDRBErs%3D&reserved=0) y [YouTube](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2FcongatecAE&data=04%7C01%7C%7Cd6654884cfee4283460108d87b43e959%7C1b738660126645879d5454e9ad89e4cb%7C0%7C0%7C637394878932444843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5jW4UF3e6O1zetb%2FFdq3Sq1R6T09OuPadNWqu6Fc%2FnY%3D&reserved=0).

\* \* \*

*Intel and Core are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*